

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
TDK Corporation	06/15/2005
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	Senju Metal Industry Co., Ltd.
Street Address:	23 Senju-Hashidocho, Adachi-ku
City:	Tokyo
State/Country:	JAPAN
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	6402013
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(202)373-6001
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	(202) 373-6000
Email:	ruby.ross-gilliam@tempbingham.com
Correspondent Name:	BINGHAM McCUTCHEN LLP
Address Line 1:	2020 K Street NW
Address Line 4:	Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20006-1806
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	7031169001
NAME OF SUBMITTER:	/Matthew L. Fedowitz/
Total Attachments: 5 source=7031169001_Patent_Transfer_Agreement_filed_04302010#page1.tif source=7031169001_Patent_Transfer_Agreement_filed_04302010#page2.tif source=7031169001_Patent_Transfer_Agreement_filed_04302010#page3.tif source=7031169001_Patent_Transfer_Agreement_filed_04302010#page4.tif source=7031169001_Patent_Transfer_Agreement_filed_04302010#page5.tif	

CH \$40.00 6402013

501163615

PATENT
REEL: 024312 FRAME: 0760

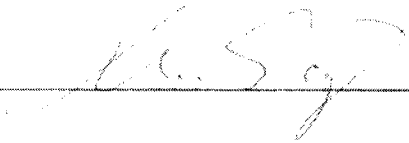
VERIFICATION OF A TRANSLATION

I, the below named translator, hereby declare that the English translation of the Patent Transfer Agreement is a true and complete translation.

Full name of the translator

MASAMIRO SAMETAMA

Signature of the translator



Date: Apr. 28, 2010

特許権等譲渡契約書

TDK株式会社（以下「甲」という）と千住金属工業株式会社（以下「乙」という）とは、甲乙共同で保有する特許権および特許を受ける権利について、甲の権利および持分を乙へ譲渡することにつき、以下の通り本契約を締結する。

第1条（目 的）

甲は乙に対し、以下の甲乙共同で保有する特許権および特許を受ける権利（以下総称して「特許権等」という）について、自らの権利および持分を乙へ譲渡する。

（1）日本国出願特許

出願番号：特願2000-368896「熱硬化はんだ付け用フラックスおよびはんだ付け方法」

（2）米国特許

特許番号：第6,402,013号「Thermosetting soldering flux and soldering process」

第2条（譲渡対価および実施権許諾）

1. 「特許権等」の譲渡に係る対価は、無償とする。
2. 乙は甲および甲の関係会社（議決権を有する発行済株式の過半数を貴社により直接または間接に保有されている国内外法人）に対して、無償で「特許権等」に係る第三者への再実施権不可の通常実施権を許諾する。

第3条（権利移転手続き等）

1. 乙は本契約締結後遅滞なく甲に対して「特許権等」の移転登録および名義変更ならびに持分譲渡に必要な書類を交付する。
2. 前項に係る一切の費用は乙が負担する。

第4条（不保証）

甲は、「特許権等」の有効性、有用性および第三者の権利との抵触性に関して、乙に対し何らの保証も行わない。

第5条（甲の免責）

甲は、「特許権等」に係る乙または乙の関係会社の行為に起因して、甲または甲の関係会社が第三者から「特許権等」に係る何らかの請求・問い合わせ・主張等を受けた場合は、乙に対し遅滞無く書面による通知を行うものとし、乙は当該通知後、甲および甲の関係会社を免責し、甲および甲の関係会社に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

第6条（秘密保持）

乙は、本契約締結後3年間、「特許権等」に係る甲から秘密保持を条件に提供された一

切の技術情報を秘密として扱い、事前の書面による甲の同意なしに第三者にこれを開示してはならない。但し、当該技術情報について、すでに公知であること、乙が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したこと、乙が甲から技術情報を提供された時点ですでに保有していたこと、又は乙が甲から提供された技術情報によらずして独自に開発したことが書面にて立証できるものについてはこの限りでない。

第7条（協議解決）

本契約の解釈に関する疑義、または本契約に定めのない事項が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

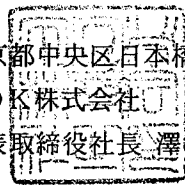
第8条（附 則）

甲および乙は「特許権等」の譲渡に伴い、平成12年6月7日付で締結した「開発・製造・販売に関する契約書」の見直しを1年以内に実施するものとする。

本契約合意締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保管する。

平成 17 年 6 月 15 日

東京都中央区日本橋一丁目13番1号
甲 TDK株式会社
代表取締役社長 澤部 肇



東京都足立区千住橋戸町23番地
乙 千住金属工業株式会社
代表取締役社長 佐藤 一策



PATENT TRANSFER AGREEMENT

The Patent Transfer Agreement (this "Agreement") is made and entered into by and between TDK Corporation ("TDK") and Senju Metal Industry Co., Ltd. ("SMIC") with respect to the transfer to SMIC of TDK's rights and share to the patent right and the right to obtain patent jointly owned by TDK and SMIC.

1. Purpose

TDK hereby transfers to SMIC its rights and share to the following patent right and the right to obtain patent jointly owned by TDK and SMIC (collectively, the "Patent Rights").

(1) Patent applied in Japan

Application No. 2000-368896 "Thermosetting Flux for Soldering and Soldering Method"

(2) U.S. Patent

Patent No. 6,402,013 "Thermosetting soldering flux and soldering process"

2. Consideration for Transfer and Licensing

2.1 The consideration for transfer of the Patent Rights shall be free of charge.

2.2 SMIC grants to TDK and its affiliates (i.e., domestic or foreign corporations of which a majority of the outstanding voting shares is owned directly or indirectly by TDK) a non-exclusive and non-sublicensable license to the Patent Rights free of charge.

3. Procedures for Transfer of Rights

3.1 SMIC will, without delay after execution hereof, deliver to TDK documents necessary to complete the registration of transfer and entry of a name change for the Patent Rights as well as the transfer of its share.

3.2 Any and all expenses relating to Section 3.1 shall be borne by SMIC.

4. No Warranty

TDK makes no warranty to SMIC as to the validity and availability of the Patent Rights and conflict with third parties' rights.

5. Indemnification on the part of TDK

TDK shall notify SMIC in writing without delay if TDK or its affiliate receives any claim, inquiry or demand relating to the Patent Rights from a third party resulting from SMIC's or its affiliates' activities relating to the Patent Rights, and SMIC shall, upon such notice, indemnify and hold TDK and its affiliates harmless and compensate for damage, if it suffered by TDK and its affiliates.

6. Confidentiality

SMIC shall, for a period of three (3) years after execution hereof, treat in confidence all technical information relating to the Patent Rights provided by TDK on condition of confidentiality and shall not disclose them to a third party without the prior written consent of TDK; provided, however, such technical information shall not be deemed confidential if SMIC can prove in writing that it is already in the public domain, it is lawfully obtained by SMIC from a third party without the obligation of confidentiality, it is already in its possession at the time of the provision of technical information from TDK, or it is independently developed by SMIC without reference to technical information provided by TDK.

7. Consultation and Settlement

Any doubt about the interpretation of this Agreement or matters not stipulated herein shall be discussed and settled in good faith by the parties.

8. Supplementary Provisions

TDK and SMIC shall review the "Agreement on Development, Manufacture and Marketing" entered into on the date of June 7, 2000 within one (1) year after transfer of the Patent Rights.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed in duplicate, affix their signatures and seals and keep one (1) copy each.

Date: June 15, 2005

TDK Corporation
1-13-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

Senju Metal Industry Co., Ltd.
23 Senju-Hashidocho, Adachi-ku, Tokyo

By: _____

Name: Hajime Sawabe

Title: President and CEO

By: _____

Name: Issaku Sato

Title: CEO